(12) 公開特許公報(A)

					(43)公開日	平成14年10月23日(2002.10.23)
						(P2002-311442A)
						特開2002-311442
- 開	特	許	公	報	(A)	(11)特許出願公開番号

(51) Int.CL ⁷		識別記号		FI			テーマコード(参考)
G02F	1/1341			G 0 2 F	1/1341		2H088
	1/13	101	· .		1/13	101	2H089

請求項の数8 OL (全 10 頁) 審査請求 有

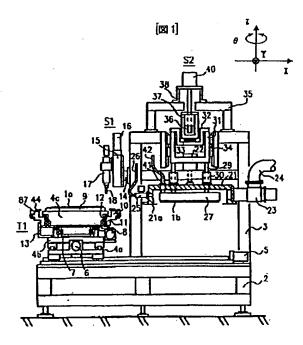
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
(21)出願番号	特顧2001-118362(P2001-118362)	(71)出願人	000233077
	•		株式会社 日立インダストリイズ
(22)出顧日	平成13年4月17日(2001.4.17)		東京都足立区中川四丁目13番17号
		(72) 発明者	川隅幸宏
			茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テ
			クノエンジニアリング株式会社開発研究所
			内
	•	(74)代理人	100059269
			弁理士 秋本 正実

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶基板の組立方法及びその組立装置及び液晶供給装置

(57)【要約】

【課題】 表示ムラの無い液晶パネルを生産すること。 【解決手段】 貼り合わせ対象物たる二枚の基板1a, 1bの内の一方の基板を加圧板27の下面に保持すると 共に他方の基板をテーブル9上に保持し、その他方の基 板上に供給される液晶剤の供給経路を不活性ガス雰囲気 にして液晶剤を供給する。そして、対向した各基板1 a、1bを各々の間隔を狭めてその各基板1a、1bの 内の何れか一方に設けた接着剤で貼り合わせること。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 貼り合わせ対象物たる二枚の基板の内の 一方の基板を加圧板の下面に保持すると共に他方の基板 をテーブル上に保持し、該他方の基板上に液晶剤を供給 した後、対向した前記各基板を各々の間隔を狭めて当該 各基板の内の何れか一方に設けた接着剤で貼り合わせる 液晶基板の組立方法であって、

前記他方の基板上に液晶剤を供給する際、該供給される 液晶剤の供給経路を不活性ガス雰囲気にした後で供給す ることを特徴とした液晶基板の組立方法。

【請求項2】 貼り合わせ対象物たる二枚の基板の内の 一方の基板を加圧板の下面に保持すると共に他方の基板 をテーブル上に保持し、該他方の基板上に液晶剤を供給 した後、対向した前記各基板を各々の間隔を狭めて当該 各基板の内の何れか一方に設けた接着剤で貼り合わせる 液晶基板の組立方法であって、

前記他方の基板上に液晶剤を供給する際、該供給される 液晶剤の供給経路を真空雰囲気にした後で供給すること を特徴とした液晶基板の組立方法。

【請求項3】 貼り合わせ対象物たる二枚の基板の内の 一方の基板を加圧板の下面に保持すると共に他方の基板 をテーブル上に保持し、該他方の基板上に液晶剤を供給 した後、対向した前記各基板を各々の間隔を狭めて当該 各基板の内の何れか一方に設けた接着剤で貼り合わせる 液晶基板の組立方法であって、

前記他方の基板上に液晶剤を供給する際、該液晶剤を噴 霧することを特徴とした液晶基板の組立方法。

【請求項4】 前記液晶剤の噴霧を、2流体ノズルから 不活性ガスを前記他方の基板上に吹き付けた後、前記2 流体ノズルから不活性ガスと液晶剤を圧送して行うこと を特徴とした請求項3に記載の液晶基板の組立方法。

【請求項5】 前記液晶剤の供給後、前記2流体ノズル から不活性ガスを噴霧して前記他方の基板上の液晶剤を 該他方の基板上の主面の広がり方向に拡散させることを 特徴とした請求項3又は4の内の何れか一つに記載の液 晶基板の組立方法。

【請求項6】 貼り合わせ対象物たる二枚の基板の内の 一方の基板を保持する加圧板と、前記各基板の内の他方 の基板を保持し且つ当該他方の基板を前記一方の基板に 対向配置可能なテーブルと、前記他方の基板上に液晶剤 を供給する液晶供給機構とを備えた液晶基板の組立装置 であって、

前記液晶供給機構は、前記他方の基板上に液晶剤を供給 する液晶供給部と、該液晶供給部近傍に配設した前記他 方の基板までの間の供給される液晶剤の周囲を不活性ガ ス雰囲気にする不活性ガスを供給する不活性ガス供給部 とを備えることを特徴とした液晶基板の組立装置。

【請求項7】 液晶基板を製造する際、液晶剤を基板上 に供給する液晶供給装置であって、

供給する液晶剤を内蔵するシリンジと、該シリンジ内の

液晶剤を前記基板上に供給する液晶供給部と、該液晶供 給部の周囲に覆設するカバーと、該カバーの内側に不活 性ガスを供給する不活性ガス供給部とを備えることを特 徴とした液晶供給装置。

(請求項8) 液晶基板を製造する際、液晶剤を基板上 に供給する液晶供給装置であって、

供給する液晶剤を内蔵するシリンジと、該シリンジ内に 連通するマニホールドと、該マニホールド内に連通する 2流体ノズルと、前記マニホールド内に不活性ガスを供 給する不活性ガス供給部とを備えることを特徴とした液 晶供給装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶剤を介在させた貼り合わせ対象物たる基板同士を対向させて保持し、 その各基板の間隔を狭めて貼合せる液晶基板の組立方法 及びその組立装置及び液晶供給装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示パネルの製造には、透明電極や 薄膜トランジスタアレイが設けられた二枚のガラス基板 を、基板の周縁部に口字状に設けたシール剤や基板の外 周部の適宜な位置に塗布した接着剤で数μm程度の極め て接近した間隔をもって貼り合わせ、その各基板と接着 剤(以下、「シール剤」ともいう。)で形成される空間 に液晶を封止するという工程がある。

【0003】従来、その液晶の封止を行う際の基板貼り 合わせ方法としては、注入口を設けないようにシール剤 をクローズしたパターン(口字形)に描画した一方の基 板上に液晶を滴下しておく。そして、真空チャンバ内に て他方の基板を一方の基板の上方に配置し、真空状態で その他方の基板と一方の基板との間隔を狭めて加圧して 上下の基板を貼り合わせる、という特開昭62-890 25号公報に開示された方法がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特 開昭62-89025号公報に開示された方法では、液 晶剤を滴下する際の空気の巻き込みにより、空気中の水 分や不純物が貼り合わされた基板と液晶剤との間に閉じ 込められ、それが基板上に滴下痕として残ってしまう、 という不都合があった。また、その水分や不純物によっ て、滴下した液晶剤の表面が酸化して滴下痕として残っ てしまう、という不都合があった。そして、その滴下痕 によって、組み立てられた液晶パネルに色ムラの不良が 生じる、という不都合があった。

【0005】本発明は、かかる従来例の有する不都合を 改善し、液晶滴下時に滴下痕の発生を抑制することによ って、表示ムラの無い液晶パネルが生産できる液晶基板 の組立方法及びその組立装置及び液晶供給装置を提供す ることを、その目的とする。 【0006】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成する為、 請求項1記載の発明では、貼り合わせ対象物たる二枚の 基板の内の一方の基板を加圧板の下面に保持すると共に 他方の基板をテーブル上に保持し、その他方の基板上に 液晶剤を供給した後、対向した各基板を各々の間隔を狭 めてその各基板の内の何れか一方に設けた接着剤で貼り 合わせる液晶基板の組立方法において、他方の基板上に 液晶剤を供給する際、この供給される液晶剤の供給経路 を不活性ガス雰囲気にした後で供給している。

【0007】請求項2記載の発明では、貼り合わせ対象 物たる二枚の基板の内の一方の基板を加圧板の下面に保 持すると共に他方の基板をテーブル上に保持し、その他 方の基板上に液晶剤を供給した後、対向した各基板を各 々の間隔を狭めてその各基板の内の何れか一方に設けた 接着剤で貼り合わせる液晶基板の組立方法において、他 方の基板上に液晶剤を供給する際、この供給される液晶 剤の供給経路を真空雰囲気にした後で供給している。

【0008】請求項3記載の発明では、貼り合わせ対象 物たる二枚の基板の内の一方の基板を加圧板の下面に保 持すると共に他方の基板をテーブル上に保持し、その他 方の基板上に液晶剤を供給した後、対向した各基板を各 々の間隔を狭めてその各基板の内の何れか一方に設けた 接着剤で貼り合わせる液晶基板の組立方法において、他 方の基板上に液晶剤を供給する際、この液晶剤を噴霧し ている。

【0009】ここで、請求項4記載の発明では、前述した請求項3記載の液晶基板の組立方法において、液晶剤の噴霧を、2流体ノズルから不活性ガスを他方の基板上に吹き付けた後、その2流体ノズルから不活性ガスと液晶剤を圧送して行っている。

【0010】また、請求項5記載の発明では、前述した 請求項3又は4の内の何れか一つに記載の液晶基板の組 立方法において、液晶剤の供給後、2流体ノズルから不 活性ガスを噴霧して他方の基板上の液晶剤をその他方の 基板上の主面の広がり方向に拡散させている。

【0011】請求項6記載の発明では、貼り合わせ対象 物たる二枚の基板の内の一方の基板を保持する加圧板

と、各基板の内の他方の基板を保持し且つその他方の基 板を一方の基板に対向配置可能なテーブルと、他方の基 板上に液晶剤を供給する液晶供給機構とを備えた液晶基 板の組立装置において、液晶供給機構は、他方の基板上 に液晶剤を供給する液晶供給部と、この液晶供給部近傍 に配設した他方の基板までの間の供給される液晶剤の周 囲を不活性ガス雰囲気にする不活性ガスを供給する不活 性ガス供給部とを備えている。

【0012】請求項7記載の発明では、液晶基板を製造 する際、液晶剤を基板上に供給する液晶供給装置におい て、供給する液晶剤を内蔵するシリンジと、このシリン ジ内の液晶剤を基板上に供給する液晶供給部と、この液 晶供給部の周囲に覆設するカバーと、このカバーの内側 に不活性ガスを供給する不活性ガス供給部とを備えている。

【0013】請求項8記載の発明では、液晶基板を製造 する際、液晶剤を基板上に供給する液晶供給装置におい て、供給する液晶剤を内蔵するシリンジと、このシリン ジ内に連通するマニホールドと、このマニホールド内に 連通する2流体ノズルと、そのマニホールド内に不活性 ガスを供給する不活性ガス供給部とを備えている。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明に係る液晶基板の組立装置 の第一実施形態について図1から図3に基づいて説明す る、

【0015】本実施形態の液晶基板の組立装置の構成を 図1に示す。この液晶基板の組立装置は、大別すると、 液晶供給装置たる液晶滴下部S1と、上基板1bを保持 する加圧板27を備えると共にその上基板1bを下基板 1aに加圧する基板貼合部S2と、下基板1aを載置保 持するテーブル9を備えるXY θ ステージT1とから構 成される。ここで、液晶滴下部S1及び基板貼合部S2 は、架台2上に立設された複数の支持柱と各支持柱間を 横架する横架材とから成るフレーム3に支持されると共 に隣接して配置され、XY θ ステージT1は液晶滴下部 S1及び基板貼合部S2と架台2との間に移動自在に配 置される。以下、これら各構成について詳述する。

【0016】液晶滴下部S1は、後述するテーブル9に 載置保持された下基板1a上(下基板1aの主面)に所 望量の液晶剤を滴下するディスペンサ17と、このディ スペンサ17を保持すると共に上下方向(図1に示すZ 軸方向)に移動させる2軸ステージ15と、このZ軸ス テージ15の上下移動を付勢するモータ16とで構成さ れる。このように構成された液晶滴下部S1は、基板貼 合部S2を支持する後述するフレーム3から突設された ブラケット14でZ軸ステージ15を保持して支持され る。

【0017】ここで、そのディスペンサ17について図 3を用いて説明する。このディスペンサ17には、滴下 部周囲を覆うカバー17kと、このカバー17k内に不 活性ガス(例えば、窒素やアルゴンガス等)等を導入す る為の配管(ホース)17hとが設けられている。ここ で、このディスペンサ17には、図示しない圧力源(例 えばポンプ)とエアフィルタが接続されており、その圧 力源から送出された不活性ガスをエアフィルタを通すこ とによって、ゴミ等の不純物を含まない不活性ガスが送 り込まれる。この送り込まれた不活性ガスは、流量調整 器17mにより流量調整され、制御部17iからの信号 により動作する電磁弁17nを介して配管17hを通 り、カバー17k内部に供給される。

【0018】一方、シリンジ17 e内には液晶剤が納め られている。ここで、この液晶剤に滴下用の圧力を加え る為に、上記送り込まれた不活性ガスが圧力調整器17 bにて加圧調整されて所定の圧力でシリンジ17eに送 られている。その液晶剤の滴下は、プランジャ式(例え ば、ノードソン社製のアキュラジェッターSシリーズ) で行われる。具体的には、制御部17iからの信号によ り動作する電磁弁17dが動作する間だけシリンジ17 e内の図示しないニードルが開くと共に、不活性ガスが シリンジ17e内に送られて液晶剤の定量滴下が行われ る。

【0019】ここで、図1には示していないが、その液 晶剤滴下用のディスペンサ17の近くにはシール剤を吐 出する為のディスペンサが配設されている。このシール 剤吐出用のディスペンサは、液晶剤滴下用のディスペン サ17と同様に図示しないブラケットを介してフレーム 3に固定されている。

【0020】基板貼合部S2は、後述する下チャンバユ ニット10と共に減圧チャンバを成す下方が開口した上 チャンバユニット21と、この上チャンバユニット21 内にシャフト29を介して配設され且つ吸引吸着機構及 び静電吸着機構を備えた加圧板27とから成り、それぞ れが独立して上下動できる構造になっている。

【0021】具体的に、上チャンバユニット21には複 数のシャフト29を挿通する図示しない貫通孔が各々形 成されている。そして、上チャンバユニット21の上部 には、その貫通孔とシャフト29との間の間隙を覆うと 共にそのシャフト29に覆設するリニアブッシュ及び真 空シールを内蔵したハウジング30と、本体をフレーム 3の横架材に固定すると共にその本体内にて上下方向に 往復移動する部材を上チャンバユニット21の上部に固 定するシリンダ22とが備えられる。このように構成す ることで、上チャンバユニット21がシャフト29をガ イドとしてシリンダ22により上下方向に移動する。

【0022】上述したハウジング30の真空シールは、 上チャンバユニット21と下チャンバユニット10とが 合体して減圧チャンバを形成し、その際にハウジング3 のが変形しても貫通孔とシャフト29との間の間隙から 真空漏れを起こさないように内蔵される。これが為、減 圧チャンバの変形によってシャフト29に負荷が掛かっ ても、その力を吸収することができる。また、シャフト 29の一端に固定された加圧板27の変形を防止でき、 後述するが如き各基板1a,1bの貼り合わせの際に、 加圧板27に保持された上基板1bとテーブル9に保持 された下基板1aとの平行を保って貼り合わせを行うこ とができる。

【0023】ここで、上チャンバユニット21の下端部 (開口の周縁部)には、下チャンバユニット10と共に 減圧チャンバを形成した際にその減圧チャンバ内を気密 する為のフランジ21 aが設けられている。

【0024】また、上チャンバユニット21の一方の側 部には、滅圧チャンバ内を滅圧する為に、滅圧チャンバ 内に連通する配管ホース24と、この配管ホース24の 途中に配設された真空バルブ23と、配管ホース24に 接続された図示しない真空ボンプとが備えられる。 【0025】更に又、上チャンバユニット21の他方の

側部には、減圧された減圧チャンバ内を大気圧に戻す為 に、減圧チャンバ内に連通するガスパージバルブ25 と、このガスパージバルブ25に一端が接続されたガス チューブ26と、このガスチューブ26の他端に接続さ れた窒素やクリーンドライエアー等を送出する加圧ポン フとが備えられる。

【0026】ここで、上チャンバユニット21の上部に は加圧板27に形成された図示しないマーク認識用孔を 通して各基板1a,1bの位置合わせマークを観測する 為の窓が複数設けられる。この場合、その位置合わせマ ークの観測には、上チャンバユニット21の窓の上方に 配設された図示しない画像認識カメラが用いられ、この 画像認識カメラによって各基板1a,1bの位置合わせ マークのずれを測定する。

【0027】続いて、加圧板27は、前述したが如くシ ャフト29の一端に固定されている。ここで、このシャ フト29の他端はハウジング31に固定されており、こ のハウジング31の両側部に配設されたリニアガイド3 4とそのリニアガイド34に係合するフレーム3に設け られたガイド部3aとによって、加圧板27の上下動が 可能な構造になっている。より具体的には、ハウジング 31の上部に配設されたハウジング32と、このハウジ ング32の上面に配設された荷重計33と、上下方向に 螺刻された雄螺子部を有し且つその荷重計33の上部に 配設されたナットハウジング37と、このナットハウジ ング37の雌螺子部にて回動自在に螺合するボールねじ 36と、このボールねじ36をその軸中心で回動する出 力軸を備えたモータ40とを有し、このモータ40を駆 動することによって加圧板27の上下動を行う。この場 合、モータ40は、フレーム3の上部に配設されたフレ ーム35上のブラケット38に固定される。

【0028】このように構成することで、モータ40の 駆動によって上基板1bを保持した加圧板27を下降さ せ、その上基板1bをテーブル9上の下基板1aに密着 させて貼り合わせに必要な加圧力を与えることができ る。ここで、上述した荷重計33は加圧力センサとして 働き、逐次フィードバックされた信号に基づいてモータ 40を制御することで、各基板1a,1bに所望の加圧 力を与えることが可能になっている。

【0029】以上の如く上下動する加圧板27には、前 述したように吸引吸着機構及び静電吸着機構が備えられ る。この吸引吸着機構は、加圧板27の下面から形成さ れた複数の図示しない吸引孔と、これら各吸引孔に連通 すると共に上チャンバユニット21に配設された吸引吸 着用批手41と、この吸引吸着用継手41に連通する吸 引チューブ42と、この吸引チューブ42に接続する図 示しない真空ポンプとで構成される。このように構成し た吸引吸着機構は、大気下にあっては真空ボンプを駆動 して上基板1bを加圧板27の下面に真空吸着(或いは 吸引吸着)で密着保持する。

【0030】続いて、静電吸着機構について説明する。 この静電吸着機構は、本実施形態にあっては略矩形の平 板電極から成り、加圧板27の下面の両端側に形成され た二つの略矩形の凹部に各々嵌着される。また、その平 板電極は、その表面(加圧板27の下面側)が誘電体で 覆われており、この誘電体の主面が加圧板27の下面と 面一になるよう設けられる。このように加圧板27に配 設された平板電極は、夫々正負の直流電源に適宜なスイ ッチを介して接続されている。これが為、各平板電極に 正或いは負の電圧が印加されると、上記誘電体の主面に 負或いは正の電荷が誘起される。そして、その電荷によ って上基板1bに形成されている透明電極膜との間に発 生するクーロシカで上基板1bが加圧板27に静電吸着 される。ここで、各平板電極に印加する電圧は、同極で もよいし、夫々異なる双極でもよい。

【0031】尚、その周囲が大気の場合は、前述した吸 引孔による吸引吸着を行った方がよい。その理由は、静 電吸着を行う場合、上基板1bと加圧板27の間に空気 層があると、静電気による放電現象が発生して上基板1 bや加圧板27を損傷してしまう。これが為、例えば上 基板1bを加圧板27に最初に密着保持するときは周囲 が大気下にあるので、先ず吸引吸着機構で吸着し、減圧 チャンバ内を減圧していって放電現象が発生しない程度 まで減圧されてから静電吸着を行うことが望ましい。

【0032】ここで、後述するが如く加圧板27にて上 基板1bを吸引吸着している状態で減圧チャンバ内を減 圧していくと、その吸着力が小さくなり上基板1bが落 下する虞がある。これが為、上チャンバユニット21に は、加圧板27の僅か下の位置で上基板1bを受け止め る受止爪60が設けられている。この受止爪60は、図 2に示すように、上基板1bの対角位置たる二つの角部 に対応して配設されており、上チャンバユニット21か ら下方に向けて延設したシャフト59で釣り下げ保持さ れる。

【0033】具体的には、図示しないが、上チャンバユ ニット21に形成された貫通孔にシャフト59が挿通さ れており、このシャフト59がその軸中心で回転し且つ 上下移動できるように構成されている。この場合、減圧 チャンバ内が真空漏れを起こさないようにシャフト59 に真空シールが覆設されている。上記回転はシャフト59 の端部に接続された図示しない回転アクチェータによ って、上下移動は同様にシャフト59の端部に接続され た図示しない昇降アクチェータによって行われる。この ようにシャフト59を回転又は上下移動させることによ って、各基板1a,1bの貼り合わせを行ない、下基板 1a上に滴下された液晶剤を各基板1a,1bの主面の 広がり方向に拡張させる場合に邪魔にならぬように受止 爪60を退避させることができる。

【0034】次に、XY θ ステージT1について説明す る。このXY θ ステージT1は、架台2上に配設された Xステージ4aと、このXステージ4a上に配設された Yステージ4bと、このYステージ4b上に配設された θ ステージ4cと、この θ ステージ4c上に配設され且 つ下基板1aを載置保持するテーブル9と、Yステージ 4b上にプレート13を介して固定され且つ上チャンバ ユニット21と共に減圧チャンバを成す上方が開口した 下チャンバユニット10とを有する。

【0035】本実施形態のXステージ4aは、駆動モー タ5によってYステージ4b, θステージ4c, テーブ ル9並びに下チャンバユニット10を左右方向(図1中 のX軸方向)に、即ち液晶滴下部S1と基板貼合部S2 の下方にて往復移動できるよう構成される。また、Yス テージ4bは、駆動モータ6によってθステージ4c, テーブル9並びに下チャンバユニット10を前後方向

(図1中のY軸方向)に移動できるよう構成される。更 に又、θステージ4cは、回転ベアリング7を介し駆動 モータ8によってYステージ4bに対して図1に示すθ 方向に回転するよう構成される。ここで、θステージ4 cは、下チャンバユニット10に対し回転ベアリング1 1と真空シール12を介して回転自在に取付けられてお り、これにより&ステージ4cが回転しても下チャンパ ユニット10がつられて回転しない構造となっている。 【0036】ここで、下基板1aはテーブル9上で重力 方向に載置されているので、その下基板1aの位置決め を図る為に、テーブル9には、図2に示すように、下基 板1aの隣り合う二つの周縁部に対応して各々配設され た複数の位置決め部材81と、下基板1aの残りの二つ の周縁部に対応して各々配設された複数の押付ローラ8 2とを有する位置決め機構が備えられる。この押付ロー ラ82は、例えば図2に示す矢印方向にテーブル9上を 移動できるよう構成されており、各押付ローラ82で下 基板1aを位置決め部材81に押付けることによって、 その下基板1 aの水平方向 (テーブル9の面方向)の位 置決めを行うと共にテーブル9上での保持を行う。

【0037】しかしながら、各基板1a,1bを貼り合 わせる直前の微小位置決めの際に、上基板1bが下基板 1a上のシール剤や液晶剤と接触した影響で下基板1a がずれたり持上がる虞がある。又は、減圧チャンバ内を 減圧する際に、その減圧過程で下基板1aとテーブル9 との間に入り込んでいる空気が逃げ、これにより下基板 1aが踊ってずれてしまう虞がある。これが為、そのテ ーブル9にあっても、前述した加圧板27と同様に構成 された吸引吸着機構及び静電吸着機構が備えられてお り、これによりテーブル9上に下基板1aが密着保持さ れる。

【0038】ここで、そのテーブル9には、下基板1a の載置面から突出可能であり且つ上下方向に移動自在な 図示しないピンが複数配設される。このようにピンを設 けることによって、各ピンを上昇させて貼り合わせ後の 基板を押し上げることができ、これによりテーブル9か らの取り出しを容易にしている。また、例えば各ピンを 上昇させた際にテーブル9に当接させることで接地状態 にし、貼り合わせ後の基板の除電を行なうことができ る。

【0039】 続いて、下チャンバユニット10には、上 **端部 (開口の周縁部) に配設されたOリング44と、こ** のOリング44の外側に配設されたボールベアリング8 7とが備えられる。このようにOリング44を設けてい るので、後述するが如く上チャンバユニット21を下降 させてそのフランジ21 aをOリング44に当接させた 際に、各チャンバユニット10,21が一体となり、減 圧チャンバとして機能させることができる。また、ボー ルベアリング87は、減圧チャンバを減圧した際の〇リ ング44のつぶれ量を調整する為に、上下方向の任意の 位置に設定できるよう構成される。このようにボールベ アリング87の位置を適宜調整することによって、減圧 により掛かる大きな力を、ボールベアリング87を介し て下チャンバユニット10で受けることができる。そし て、このようなボールベアリング87が配設されること によってOリング44の弾性変形が可能となるので、後 述する貼り合わせ時に、XYのステージT1をOリング 44の弾性範囲内で容易に微動させ精密に位置決めする ことができる。

【0040】次に、本実施形態の液晶基板の組立装置の 動作を説明する。

【0041】先ず、テーブル9に上基板1bを保持した 治具を図示しない移載機のハンドを用いて載置した後、 駆動モータ5を駆動してXステージ4aを動かし、XY ØステージT1を基板貼合部S2の下に移動させる。そ して、モータ40を駆動して加圧板27を下降させ、テ ーブル9上の上基板1bを加圧板27に吸引吸着する。 しかる後、モータ40を駆動して加圧板27を上昇さ せ、その加圧板27に上基板1bを保持した状態で待機 させる。

【0042】上基板1bの加圧板27への保持が終了す ると、駆動モータ5を駆動してXYのステージT1を液 晶滴下部S1の下に移動する。そして、テーブル9から 空になった治具を外してそのテーブル9上に移載機のハ ンドを用いて下基板1aを載置し、この下基板1aを前 述した図2に示す位置決め部材81と押付ローラ82で 位置決めして保持する。

【0043】テーブル9上に下基板1aが保持される と、各駆動モータ5,6を駆動し、Xステージ4aとY ステージ4bを動かしてXYのステージT1をX軸,Y 軸方向に移動させながらシール剤吐出用のディスペンサ から下基板1a上にシール剤を吐出する。その際、下基 板1a上にはクローズしたパターン(例えば口字形)で シール剤が塗布される。このようにしてシール剤を塗布 した後、そのシール剤から成る枠内にディスペンサ17 から液晶剤を必要量だけ滴下する。この場合、Xステー ジ4 aとYステージ4 bを動かしてXY ØステージT1 をX軸, Y軸方向に移動させながら、ディスペンサ17 のカバー17 k内に不活性ガスを供給して下基板1a上 の任意の複数箇所に所望量の液晶剤を滴下する。

(0044)ここで、説明を省略したが、上基板1b又 は下基板1aには予めスペーサが散布され、若しくは貼 付けられている。この場合のスペーサとは、各基板1 a、1bを貼り合わせる際に、その各基板1a、1b間 の隙間が所定量以下とならないようにするものである。 尚、そのスペーサを液晶剤に混入しておき、液晶塗布と 共にスペーサの散布を行ってもよい。

【0045】前述したが如く液晶剤が必要量だけ滴下された後、駆動モータ5を駆動してXYのステージT1を 基板貼合せ部S2の下の所定位置に移動する。そして、 XYのステージT1が停止すると、シリンダ22を作動 させて上チャンバユニット21を下降させ、そのフラン ジ部21aをOリング44に当接させる。これにより、 下チャンバユニット10と上チャンバユニット21とか ら成る減圧チャンバが形成される。

【0046】 減圧チャンバが形成された後、真空バルブ 23を開放して減圧チャンバ内を減圧していく。その 際、前述したが如く上基板1bは加圧板27に吸引吸着 された状態である為、減圧チャンバ内の減圧が進み真空 化していくと上基板1bに作用していた吸引吸着力が徐 々に小さくなってその上基板1bを保持できなくなり、 上基板1bが自重で落下する。これが為、前述した回転 アクチェータや昇降アクチェータによって図2に示す受 止爪60を動かし、上基板1bを受止爪60で受け止め て加圧板27の僅かに下の位置に保持する。

【0047】減圧チャンバ内が充分減圧された時点で、 加圧板27に設けた静電吸着機構に電圧を印加し、受止 爪60上にある上基板1bを加圧板27にクーロン力で 保持する。その際、減圧チャンバ内は既にかなり減圧さ れており、加圧板27と上基板1bの間に空気が残って いないので、静電気による放電が発生しない。また、空 気が逃げるときに発生する上基板1bの踊りもない。 【0048】上基板1bが静電吸着されると、シャフト 59を昇降アクチェータで下降させ且つ回転アクチェー タで回転させて、受止爪60を各基板1a, 1bの貼り 合わせの邪魔にならぬように待避させる。そして、モー タ40を駆動して加圧板27を下降させ、上基板1bを 下基板1aに接近させる。しかる後、画像認識カメラを 用いて各基板1a.1bに設けた位置合わせマークを読 み取って画像処理で位置ずれの測定を行い、この測定値 に基づきXステージ4 a, Yステージ4 b並びにθステ ージ4 cの動作制御を行ってテーブル9を微動させ、下 基板1aと上基板1bとの高精度な位置合わせを行う。

ここで、下チャンバユニット10には前述したが如きボ ールペアリング87が配設されているので、その微動の 際にボールベアリング87が各チャンバユニット10、 21の間隔を維持でき、Oリング44を極端に変形させ ないで真空状態(減圧状態)を維持することができる。 【0049】その位置合わせが終了すると、加圧板27 を更に下降させ、上基板1bの下面を下基板1a上のシ ール剤に接触させる。その際、荷重計33でシール剤に 掛かる加圧力を計測しながらモータ40の駆動力を制御 して各基板1a,1bを所望間隔に貼り合わせる。この 場合、上基板1bは加圧板27に静電吸着力により密着 している為その中央部が垂れ下がることはない。従っ て、液晶剤中のスペーサに悪影響を与えたり、基板1

a,1b同士の位置合せ不良が生じることはない。

【0050】ここで、貼り合わせる基板の面積が大きく なると、前述した加圧力による貼り合わせだけでは十分 にシール剤を潰すことができない。これが為、その加圧 力による貼り合わせ(予備加圧)が終了すると、加圧板 27の静電吸着を解除し、シリンダ22を動作して上チ ャンバユニット21を上昇させる。そして、真空バルブ 23を締めてガスパージバルブ25を開き、真空チャン バ内に窒素ガスやクリーンドライエアーを供給して大気 圧に戻す。このように真空チャンバ内を大気圧に戻すこ とによって液晶基板面に圧力を加え、所望の厚みに確実 に貼り合わせる(本加圧)。

【0051】ここで、真空チャンバ内圧力を真空状態から大気圧へと変化させた際に、基板1a,1b間における液晶剤間の空間部分が真空状態である為、各基板1

a、1bには略均一にその外部から大きな圧力が加わ る。例えば各基板1a、1b間の空間部分が真空状態の ときに大気圧を加えると121.6kNの力を掛けるこ とができる。上記本加圧は、その各基板1a、1bに掛 かる圧力を利用して貼り合わせを行うものである。

【0052】貼り合わせが終了すると、ガスパージバル ブ25を閉じ、XY&ステージT1を液晶滴下部S1の 下に戻してテーブル9から貼り合わせた基板を移載機の ハンドで取り出し、次の基板の貼り合わせに備える。そ の取り出された貼り合わせ後の基板は、下流のUV光照 射装置や加熱装置等に送られてシール剤の硬化が行われ る。

【0053】以上示したが如く、本実施形態にあっては シール剤を塗布し、更に不活性ガス雰囲気又は真空雰囲 気中で液晶剤を滴下した後直ちに貼り合わせ工程に移行 することができるので、貼り合わせ前の基板に塵埃が付 着し難い。そしてこれが為、貼り合わせ後の基板にて前 述した従来例の如き滴下痕等に起因する不良品が発生し 難く、生産時の歩留まり向上を図ることができる。ま

た、下基板1aを保持したままXYのステージT1を移 動し、その下基板1aを上基板1bに加圧することで基 板面全体に液晶剤を広げるので、下基板1aへの液晶剤 の供給箇所を減らすことができ且つ供給量のばらつきを 小さくすることができる。即ち、液晶剤の拡張を貼り合 わせる基板同士で行うので、短時間で液晶剤供給工程か ら貼り合わせ工程に進むことができ、生産性が向上す る。

【0054】また、液晶剤の供給量のばらつきを小さく することができる、即ちディスペンサ17から不活性ガ スを供給して正確な量の液晶剤を供給することができる ので、液晶剤の無駄な消費を無くすことができ、且つ液 晶剤がシール剤のパターンの外側に溢れて基板を汚染す る度がなくなる。この場合、汚染された基板の洗浄工程 が不要となるので、更なる生産性の向上を図ることがで きる。

【0055】更に又、下基板1aを載置保持するXYの ステージT1を上基板1bの上チャンバユニット21へ の搬送に利用できるので、上基板1b搬送用の他の機構 を設けなくてもよく、組立装置の小型化を図ることができる。

【0056】尚、本発明は、必ずしも上記実施形態の態 様に限定するものではなく、以下の如く実施してもよ い。

(1)下基板1bに滴下された液晶剤は、本実施形態の 如き点状以外の形状、例えば線状等であってもよい。

(2)液晶剤を拡張させる基板同士の相対的移動方向 は、液晶剤がシール剤のパターンを超えて外部に漏れな い範囲であれば、円形や渦巻き型等の如何様なものであ ってもよい。

(3)上基板1bは、XYのステージT1に搭載せず に、本実施形態にてXYのステージT1に搭載する為に 使用される移載機のハンドから直接加圧板27に搬送し て吸引吸着させてよい。

(4)本実施形態にあっては、ディスペンサ17の周囲 をカバー17kで囲い、局所的に不活性ガスを供給する 方式を例示したが、組立装置全体を不活性ガス雰囲気の チャンバー内に配設したり、減圧チャンバー内に配設し たりすることで、液晶剤滴下雰囲気を不活性ガスや真空 (減圧)状態にしてもよい。

(5)本実施形態にあっては、下基板1aにシール剤を 塗布する場合について例示したが、上基板1bに塗布し てもよい。但し、この場合は、上基板1bにシール剤を 塗布した後、上基板1bを反転させる工程が必要となる ので、どちらの基板にシール剤を塗布するかについて適 宜選択することが望ましい。

【0057】次に、本発明に係る液晶基板の組立装置の 第二実施形態について説明する。ここで、以下に示す符 号の内の前述した第一実施形態と同一の符号は、その第 ・一実施形態の構成と同一のものを示す。

【0058】本実施形態と第一実施形態とで異なる点 は、その第一実施形態にあっては液晶剤の滴下を不活性 ガス又は真空雰囲気中で行うようにしたが、本実施形態 にあっては下基板1 aの液晶滴下面における滴下痕を更 に少なくする為、液晶剤を噴霧するようにした点にあ る。そして、これによりその滴下痕が液晶パネルの表示 に影響を及ぼさなくなる。また、第一実施形態にあって は基板貼り合わせ時に液晶剤を広げる方式であったが、 本実施形態にあっては貼り合わせ前に液晶剤を広げる方 式としている点も異なる。

【0059】本実施形態に係る組立装置の構成は、以下 の点を除いて第一実施形態の構成と同一である。その異 なる点とは、第一実施形態のディスペンサ17に替えて 図4に示す他のディスペンサ47を設け、液晶剤や不活 性ガスを後述する2流体ノズル47a(例えば、霧のい けうち社製、2流体ノズルBINV4502)から噴霧するよう にした点にある。例えば、本実施形態にあっては粒子が 10μm程度の噴霧を行う。

【0060】このディスペンサ47は、第一実施形態の ディスペンサ17と同様に、液晶剤が納められたシリン ジ47eと、後述するが如く送り込まれた不活性ガスの 圧力を加圧調整する第一圧力調整器47bと、この第一 圧力調整器47bから送出された不活性ガスをシリンジ 47e内に導く配管47h₁と、制御部47iからの信 号により動作する第一電磁弁47dとを有する。

【0061】また、このディスペンサ47には、シリン ジ47 eの先端部に配設されたそのシリンジ47 eの内 部と連通する接続部材47fと、この接続部材47fを 介してシリンジ47 eの内部と連通するマニホールド4 7gと、後述するが如く送り込まれた不活性ガスの流量 調整を行う第二圧力調整器47mと、この第二圧力調整 器47mから送出された不活性ガスを制御部47iから の信号により動作する第二電磁弁47nを介してマニホ ールド47g内に供給する配管47h₁と、マニホール ド47gに供給された液晶剤及び不活性ガスを吐出する 2流体ノズル47aとが設けられている。この場合、第 一電磁弁47dと第二電磁弁47nは、制御部47iに よって個別に動作制御が可能である。

【0062】ここで、このディスペンサ47には、第一 実施形態のディスペンサ17と同様に図示しない圧力源 (例えばボンプ)とエアフィルタが接続されており、そ の圧力源から送出された不活性ガスをエアフィルタを通 すことによって、ゴミ等の不純物を含まない不活性ガス が送り込まれる。その送り込まれた不活性ガスは、第二 圧力調整器47mにより所定圧(本実施形態にあっては 0.1MPa)に加圧調整され、第二電磁弁47nを動 作させることでマニホールド47gに供給される。ま た、その送り込まれた不活性ガスは、第一圧力調整器4 7bにより所定圧(本実施形態にあっては0.3MP a)に加圧調整され、その所定圧を加圧調整された不活 性ガスによってシリンジ47e内に常時掛けている。 【0063】液晶剤の吐出はプランジャ式で行われる。 具体的には、第一電磁弁47dが動作する間だけシリン ジ47e内の図示しないニードルが開くと共に、シリンジ17e内に掛けられた不活性ガスの圧力によってマニホールド47gに液晶剤が圧送される。そして、2流体ノズル47aにより霧化された液晶剤47jが定量噴霧される。

【0064】次に、本実施形態の組立装置の動作を説明 する。

(0065)ここで、本実施形態における液晶剤を下基板1aに供給するまでの工程と、その供給後の貼り合わせ工程は第一実施形態と同様である為、以下においては液晶剤の供給工程のみを説明する.

【0066】液晶剤を下基板1aに供給する際は、先ず 第二電磁弁47nを動作し、第二圧力調整器47mで 0.1MPaに加圧調整された不活性ガスをマニホール ド47gに供給する。そして、2流体ノズル47aから 不活性ガスのみを噴霧して、テーブル9上に載置された 下基板1aの周囲を予め不活性ガス雰囲気にしておく。 しかる後、第一電磁弁47dを動作してマニホールド4 7gに液晶剤47jの供給を行う。この場合、大気中の 水分や不純物を巻き込むことなく液晶剤47jが噴霧さ れて下基板1a上に予め設定された量が供給される。

【0067】次に、第一電磁弁47dを閉じて液晶剤の 供給を停止する。ここで、第二電磁弁47nは動作状態 を保っており、不活性ガスが連続して噴霧されるように する。これにより、下基板1a上に噴霧された液晶剤が その不活性ガスによって拡散するので、下基板1a上に 滴下痕をつけることが無くなる。このようにして液晶剤 をシール剤のパターンの内側に十分に行き渡らせた後、 第一実施形態と同様にして基板の貼り合わせを行う。

【0068】以上示したが如く、本実施形態にあって は、シール剤を塗布した後で下基板1 aの周囲を不活性 ガス雰囲気とし、その不活性ガス雰囲気中で液晶剤を下 基板1 aに噴霧して供給し、直ちに貼り合わせ工程に移 行することができるので、貼り合わせ前の基板に塵埃が 付着し難い。そしてこれが為、貼り合わせ後の基板にて 前述した従来例の如き滴下痕等に起因する不良品が発生 し難く、生産時の歩留まり向上を図ることができる。ま た、液晶剤を噴霧することによって貼り合わせ工程の前 に予め液晶剤が基板面全体に広げられるので、下基板1 aへの液晶剤の供給箇所を減らすことができ且つ供給量 のばらつきを小さくすることができる。そして、これに より短時間で液晶剤供給工程から貼り合わせ工程に進む ことができ、生産性が向上する。

(0069)また、液晶剤の供給量のばらつきを小さく することができる、即ちディスペンサ47から正確な量 の液晶剤を供給することができるので、液晶剤の無駄な 消費を無くすことができ、且つ液晶剤がシール剤のパタ ーンの外側に溢れて基板を汚染する虞がなくなる。この 場合、汚染された基板の洗浄工程が不要となるので、更 なる生産性の向上を図ることができる。 【0070】更に又、下基板1aを載置保持するXY ステージT1を上基板1bの上チャンバユニット21へ の搬送に利用できるので、上基板1b搬送用の他の機構 を設けなくてもよく、組立装置の小型化を図ることがで きる。

【0071】尚、本発明は、必ずしも上記実施形態の態 様に限定するものではなく、以下の如く実施してもよ い。

【0072】(1)液晶剤を噴霧する2流体ノズル47 aは、噴霧粒径,噴霧範囲や液晶剤の粘度等に応じて適 宜変更してもよい。

(2)液晶剤を定量供給するプランジャ式のディスペン サ47は、その方式を問わず、定量供給できるものであ れば如何なるディスペンサでもよい。

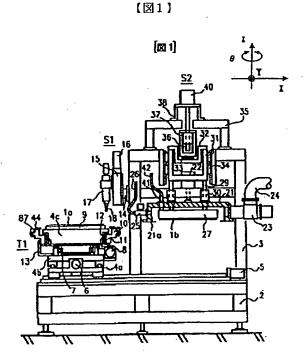
(3)第一及び第二の圧力調整器17b,17mで調節 される圧力は、液晶剤の噴霧粒径,噴霧範囲や液晶剤の 粘度等に応じ適宜調節してもよい。

(4)液晶剤の噴霧中は下基板1 aがテーブル9上に固定され且つXY & ステージT1を固定しているが、この 状態でテーブル9をXY方向に移動させて噴霧範囲を変更してもよい。

【0073】尚、前述した各実施形態にあっては、液晶 供給部分と貼り合わせ部分とが一体となったものを例示 しているが、必ずしもこれに限定するものではなく、別 々の装置で構成してもよい。

[0074]

【発明の効果】本発明によれば、基板への液晶剤の供給 時に、空気中の水分や不純物の巻き込みが無くなり、更 には液晶剤を酸化させることなくなるので、液晶剤の滴



下痕の発生を抑制することができ、これにより表示ムラ の無い液晶パネルが生産できるという、従来にない優れ た液晶基板の組立方法及びその組立装置及び液晶供給装 置を得ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る基板貼り合わせ装置の第一実施形態の構成を示す部分断面図である。

【図2】本実施形態に係る上基板の受止爪や下基板の位 置決め機構を説明する斜視図である。

【図3】本実施形態に係る液晶剤供給用のディスペンサの構成を説明する説明図である。

【図4】本発明に係る基板貼り合わせ装置の第二実施形 態に用いられるディスペンサの構成を説明する説明図で ある。

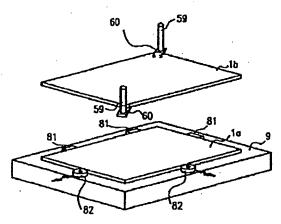
【符号の説明】

1a,1b 基板

- 9 テーブル
- 17 ディスペンサ(液晶供給機構,液晶供給装置)
- 17e シリンジ
- 17k カバー
- 17m 流量調整器(不活性ガス供給部)
- 17n 電磁弁(不活性ガス供給部)
- 27 加圧板
- 47 ディスペンサ(液晶供給機構,液晶供給装置)
- 47a 2流体ノズル
- 47e シリンジ
- 47g マニホールド
- 47m 第二圧力調整器(不活性ガス供給部)
- 47n 第二電磁弁(不活性ガス供給部)

【図2】

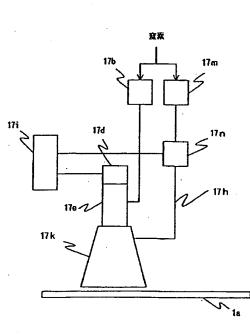
[図 2]

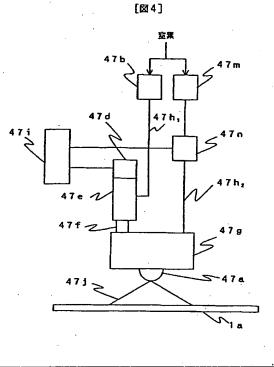












フロントページの続き

(72)発明者 石田 茂 茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立デ クノエンジニアリング株式会社開発研究所 内

(72) 発明者 八幡 聡

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社竜ケ崎工場 内 (72)発明者 村山 孝夫
茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社竜ケ崎工場内
(72)発明者 平井 明
茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社竜ケ崎工場内
Fターム(参考) 2H088 FA01 FA09 FA16 FA20 FA30

ドターム(参考) 20088 FAOT FAO9 FAT6 FA20 FA30 MA04 MA18 MA20 20089 NA22 NA33 NA38 NA39 NA49

NA60 QA08 QA12 QA15